

第61回 グライディング・ アカデミー 研磨加工の基礎 —基礎から最新技術まで—

【主催】(公社)砥粒加工学会

砥粒加工学会では、加工技術の基礎から最新技術までを理解するための入門教育講座として「グライディング・アカデミー」を定期的で開催しています。切削、研削、研磨、工作機械の分野の第一人者によるわかりやすい講義は、毎回ご好評をいただいております。今回は、研磨加工の基本原則から現場に必要な知識までを詳しくご講義いただきます。もう一度学習したい技術者や新入社員、大学院の学生の皆様方の多数の聴講をお待ちしております。また、本講義は教育に重点を置いた教材を使用いたしますので、学校教員の皆様の教育手法の向上セミナーとしても十分活用できる内容になっております。

◆日時： 令和8年6月11日(木) 13時00分～17時40分

◆場所： 立命館東京キャンパス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階

JR東京駅 日本橋口出口直結 徒歩1分 (<https://www.ritsumei.ac.jp/tokyocampus/access/>)

◆内容：

13:00～13:05 開催の挨拶

13:05～13:50 研磨加工/CMP技術の基礎と応用I

～研磨の原点から先端的半導体デバイスを支える超精密研磨/CMP技術～

九州大学・埼玉大学名誉教授/株Doi Laboratory 土肥 俊郎 氏

13:50～14:35 研磨加工/CMP技術の基礎と応用II

～超精密研磨/CMPの加工メカニズムとポイント～

九州大学・埼玉大学名誉教授/株Doi Laboratory 土肥 俊郎 氏

14:35～14:45 休憩

14:45～15:30 研磨加工/CMP技術の基礎と応用III

～超精密平坦化CMPの基本技術と次世代3Dデバイス(後工程)への応用～

九州大学・埼玉大学名誉教授/株Doi Laboratory 土肥 俊郎 氏

15:30～16:30 研磨加工/CMP技術の基礎と応用IV

～超難加工・化合物半導体/ダイヤモンド基板の加工プロセス/Beyond the CMP技術～

九州大学・埼玉大学名誉教授/株Doi Laboratory 土肥 俊郎 氏

16:30～16:40 休憩

16:40～17:40 ECMPによるSiCウエハ加工の高速化と実用化開発

(株)ジェイテックコーポレーション 田中智之氏

◆定員： 50名(先着順で定員になり次第締切ります)

◆参加費： 正会員・賛助会員 15,000円(税抜13,637円,消費税率10% 税額1,363円)

学生会員 5,000円(税抜4,546円,消費税率10% 税額454円)

シニア会員 10,000円(税抜9,091円,消費税率10% 税額909円)

非会員 30,000円(税抜27,273円,消費税率10% 税額2,727円)

学生非会員 10,000円(税抜9,091円,消費税率10% 税額909円)

◆申込締切： 令和8年5月15日(金)

◆申込先： 砥粒加工学会 web サイト[行事案内]>[イベント情報]にて、第61回グライディング・アカデミー
https://www.jsat.or.jp/GrindingAcademy61_260611の登録フォームよりお申し込みください。

◆注意事項： 個人単位でお申込みください。

◆問合せ先： (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 セラミックビル4F
TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail staff@jsat.or.jp